

# 268 含芯焊锡丝

零卤素, 免洗, 针对机器人和手工焊接应用的含芯焊锡丝

## 产品描述

Kester 268 含芯焊锡丝是一款专门针对机器人焊接进行优化的无卤素焊锡丝。依靠其独特的化学配方设计, 268焊锡丝在电子行业的机器人焊接和手工焊接中能提供稳定的工作表现, 其性能达到或超过传统的以卤素或卤离子为基础的配方。268焊锡丝能够防止出现桥接和拉尖缺陷, 得到干净的焊点, 甚至在细间距自动拖焊中也能有同样的表现。使用268焊锡丝进行焊接后残留非常干净, 不需要清洗。268焊锡丝根据IPC J-STD-004B标准被定义为ORL0类型。268焊锡丝没有主动添加氯和溴, 是一款零卤素和无卤化物的产品, 满足IEC 61249-2-21, JPCA-ES-01和IPC-410B规格的最严格要求。有关产品兼容的列表, 请参阅Kester网站或联系Kester技术支持。

## 性能特点

- 锡球溅射低
- 没有主动添加卤素和卤离子, 满足 IEC 61249-2-21, JPCA-ES-01和IPC-410B规格的要求
- 烟雾和气味少
- 残留干净, 焊点美观
- 极好的表面润湿性和扩展性, 适合机器人焊接和手工焊接
- 制造工艺和产品质量稳定, 降低焊接的缺陷
- 优异的润湿和扩展速度, 优于含卤的产品
- 根据IPC J-STD-004B标准被定义为 ORL0类型

## RoHS认证

该产品满足欧盟限制有害物质 (RoHS) 指令的要求, 2002/95/EC 条款 4。(只适用于该助焊剂配合无铅合金)

## 可靠性特性

### 铜镜测试: 低

基于 J-STD-004B, IPC-TM-650, Method 2.3.32 标准测试

### 铜腐蚀测试: 低

基于 IPC-TM-650, Method 2.6.15 标准测试

### 铬酸盐试纸测试: 未变色

基于 J-STD-004B, IPC-TM-650, Method 2.3.33 标准测试

### 卤化物定量测试: 未测得

基于 J-STD-004B, IPC-TM-650, Method 2.3.28.1 标准测试

### 卤素定量测试: 未测得

基于 IPC-TM-650, Method 2.3.35, JPCS-ES-01, prEN14582 和 IEC 61189-2 Test 2C12 标准测试

### 表面绝缘阻抗测试 (SIR) 40°C/90%

RH, IPC (典型的): 通过

基于 IPC-TM-650, Method 2.6.3.7 标准测试

## 可用性

268焊锡丝可以提供锡银铜305和K100LD无铅合金,以及锡63铅37合金的产品,助焊剂含量3.3%,并使用机器人焊接专用卷轴。针对低成本无铅焊接应用,我们推荐K100LD合金。该焊锡丝典型的线径范围为0.25-1.6毫米(0.010-0.062英寸)。如果需要其它的合金和助焊剂比例,请联系Kester的技术服务人员。更多信息请参考[www.kester.com](http://www.kester.com)。

## 需要考虑的工艺问题

烙铁头温度设定范围针对无铅合金一般为371-400°C (700-750°F),有铅合金为315-343°C (600-650°F)。在将焊锡丝添加到焊盘或元器件引脚之前需要用烙铁头对焊盘及元器件引脚进行预热。为了提高烙铁头寿命和降低锡球溅射,不要将焊锡丝直接添加到烙铁头上。

额外添加液体助焊剂应该是最后使用的方案。尽量只针对返修的焊点位置添加助焊剂。如果需要,Kester NF372-TB 可以作为增加焊点可焊性的配套液体助焊剂来使用。NF372-TB也可以做成助焊剂笔来使用,让电路板更洁净。

## 清洗

268焊锡丝拥有优异的助焊能力。其助焊剂残留物无腐蚀性,不导电,大部分应用在通常情况下不需要清洗。在焊接完成以后,IPA(异丙醇)不适用于将电路板上的残留物清除。如果需要清除助焊剂残留,需使用皂化剂或者专为清洗免洗助焊剂设计的清洗剂来清洗。如需更多的信息,请联系Kester的技术服务人员。

## 存储和保质期

必须存储在干燥,无腐蚀的环境中。随着时间,焊锡丝的表面可能会失去光泽,呈现暗灰色。这只是表面外观的变化,对产品的功能没有影响。含芯焊锡丝根据不同的合金有不同的保质期。铅含量超过70%的合金,保质期为生产日期起2年。其它合金的保质期为生产日期起3年。

## 健康与安全

本产品在处理或使用过程中,可能会对健康或环境造成危害。在使用本产品前,请认真阅读材料安全说明书和警示标签。